

2009 台北國際自動化科技大展 產學合作成果發表

◆ 專案/研究主題 探討電腦中央處理器的熱問題

◆ 學校系所 大華技術學院 自動化工程系

◆ 計畫主持人 杜鳳棋 副教授

◆ 合作夥伴
新瓷科技公司
竹翔工業公司
禾興資訊有限公司

◆ 計畫重點 「散熱問題」一直是電腦技術發展的瓶頸與挑戰，其攸關電腦的運作穩定度與效能評比。本論文係以實驗方法探討桌上型電腦CPU的散熱問題，研究重點聚焦於散熱器夾靜預負荷、散熱器與CPU的接觸面間有無塗覆散熱膏、以及風扇轉速等三種影響性的分析。

◆ 效益/特色 面對CPU的散熱問題，許多創新的構想已造就相當多具有學術價值的論文，雖然有少部分的研究已轉化成實用的研發成果，但面對CPU功率消耗持續增加的趨勢，CPU散熱技術的研究工作勢必永無止境。雖然一提到CPU的散熱問題，大多數學者專家都會想到先從散熱器著手，或提出一些理論可行但技術卻不可為的解決方式。其實再多的創意構思，不如從最基本的冷卻原理加以改進，應該才是解決CPU散熱問題的正本清源之道。

◆ 教授專長
1. 機械設計
2. 熱流學
3. 醫工科技器具設計

◆ 系統架構

